http://www.most.gov.cn/images/detail-line.jpg**科技部国际合作司关于申报2018年度中日青少年科技交流计划基层对口项目的通知**

日期：2018年01月26日      来源：科技部

科技部归口管理的 “中日青少年科技交流计划”2014年启动以来，已派遣中国青年科技人员及高中生共计5000余人赴日开展科技交流活动。作为中日科技创新合作重要内容之一，该计划有效推动了中日科技人文交流与合作，增进了中日科技界之间的沟通与理解。经我司与日本科技振兴机构协商，现共同启动2018年度中日青少年科技交流计划基层对口项目申报工作，并将有关事项通知如下：  
    一、申报范围  
    日本与亚洲青少年科技交流计划（樱花科技计划）由日本科技振兴机构全额资助，邀请亚洲各国及地区青少年短期访问日本学校、科研院所、企业等机构，并与日本青少年、科学家、研究人员等开展科技交流活动。作为日本樱花科技计划的主要内容之一，中日青少年科技交流计划面向中国大陆地区招募优秀高中生、大学生、青年科研人员等赴日交流，原则上要求首次赴日、年龄40周岁以下（领队可适当放宽）。  
    中日青少年科技交流计划基层对口项目共分三类：第一类为科学技术交流活动（A类），由日方接收单位安排中方人员赴日开展短期交流考察，在日行程原则为7天，最长可延至10天，日方合作单位为教育或科研实体（如学校、研究院所、企业等）的团组人数不超过10人（不含领队），日方合作单位为非教育或科研实体（如独立行政法人、地方公共团体、财团法人或社团法人等）的团组人数不超过15人（不含领队）；第二类为共同研究活动（B类），由日方接收单位安排中方研究人员赴日开展短期共同研究，在日行程最长不超过3周，团组人数不超过10人（不含领队）；第三类为科学技术研修活动（C类），由日方接收单位安排中方人员赴日开展短期技能培训，在日行程原则为7天，最长可延至10天，团组人数不超过15人（不含领队）。  
    申报单位种类包含政府机关、事业单位及在中国大陆境内登记注册的科研院所、学校和企业等法人单位。  
    二、申报方式  
    1.申报流程  
    中日青少年科技交流计划基层对口项目由拟开展交流的中日双方基层单位就申报批次、项目内容、人数、时间等先行沟通，达成一致后，各自向中日两国主管部门申报，中方主管部门为科技部国际合作司，具体过程管理由中日技术合作事务中心负责。  
    中方申请单位按要求填写项目申请表（见附件），报项目组织（推荐）部门，请各组织（推荐）部门审核汇总并出具推荐公函，由申请单位将推荐公函及申请表纸质版原件报送至中日技术合作事务中心，并将扫描版提交至中日技术合作平台网（www.sino-jp.com），具体方法请登陆申报系统查阅相关说明。  
    2.注意事项  
    中方派遣单位为两家或以上联合申报的，由牵头单位进行申报，并须在申请表内详述其他参与单位名称及各单位拟定派遣人数。  
    项目组织（推荐）部门为国务院有关部门外事或科技主管司局，各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团科技主管部门。  
    上述推荐公函及申请表全年有效。如当批次未获立项，可与日方继续磋商本年度后续批次交流事项。双方达成一致意见后，再次申报时中方需在系统平台提交推荐公函及申请表扫描件，无需寄送纸质版。  
    三、申报时间  
    2018年度中方项目申报分为四批次，具体为  2018年1月29日至3月6日；4月27日至5月31日；8月1日至8月31日；10月9日至11月9日。请各申报单位严格按照要求准备申报材料，在规定批次时间内登陆中日技术合作平台网申报系统提交材料（申报系统在以上所示四批申报时间以外不予开放），并及时将纸质版申报材料寄送至中日技术合作事务中心。  
    四、项目执行  
    所申报项目经科技部与日本科技振兴机构共同审核后，由中日双方管理部门分别向双方申请单位通报各批次项目立项结果，中方申请单位请关注中日技术合作平台网通知通告栏。项目立项后，请中方申请单位严格按相关规定自行办理出国手续，注意遵守国家外事纪律，项目执行完毕后及时将总结报告上传至中日技术合作平台网，否则将被取消后续交流项目申请资格。  
    五、项目联系人  
    联系人：刘晓燕、李小飞    
    电话：010-68598027、68513380  传真：010-68515808  
    邮箱：aad@cstec.org.cn  
    地址：北京市西城区三里河路54号  
    中日技术合作事务中心207室     邮编：100045

 附件：[2018年度中日青少年科技交流计划基层对口项目中方派遣单位申请表](http://www.most.gov.cn/tztg/201801/W020180126589574069154.doc)

                                                         科技部国际合作司  
                                                          2018年1月23日